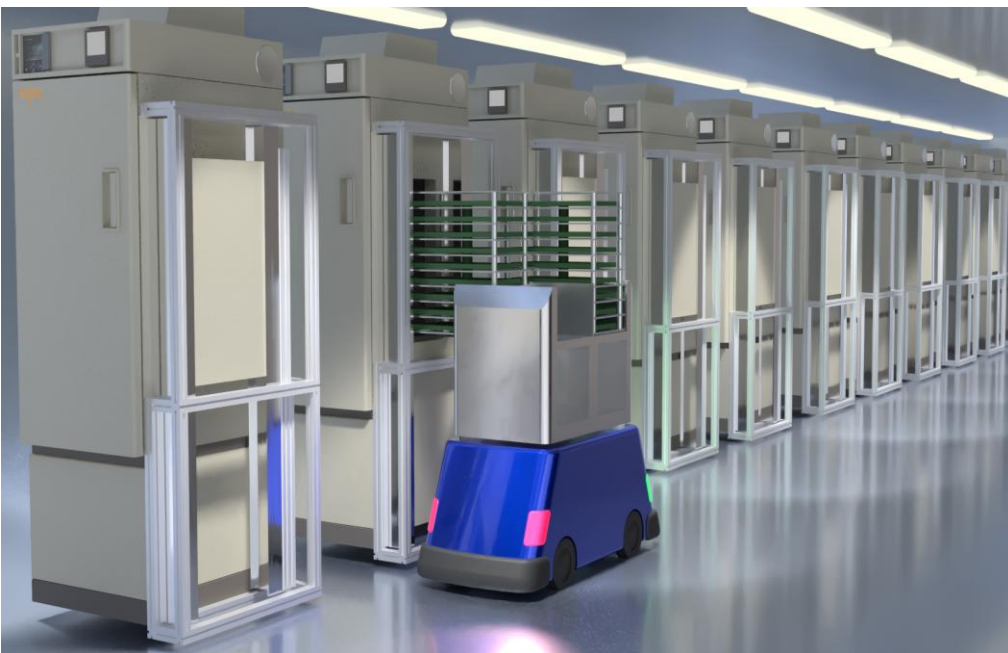


# AIサーバー・パワーデバイス用電子部品 ベーク処理用\_自動化システム

## バッチ式クリーンオープン自動化システム

\* 半導体の後工程で増加する自動化の波。

既存のオープンの加熱特性を変えずにご提案します。



### 特徴

#### ●半導体の後工程では自動化の需要が増加しています。

ポストベーク、プリベーク、アニール処理などにバッチ式オープンを多数ご利用頂いておりますが、既存のバッチ式オープンの加熱特性はそのままに自動化する方法をご提案。

#### ●上位パソコンとの通信、前後工程の自動搬送 AGVやAMRとも連携します。

・扉自動開閉、自動搬送機構 (AGV、AMR、モバイルマニピュレータ等) やワーク自動挿抜との連携、温度データ取得・読み出しなど、ホストPCの情報を受けた自動化の仕組みをご提供します。

#### ●スライド式自動扉仕様を採用し、ロボットのハンドリング考慮して高精度な位置決めが可能です。

・オープンとロボットのハンドリングの距離を最短に設置し、オーバーハングを考慮してワークを高精度に位置決めが出来ます。

### アプリケーション事例

項目	仕様	
主な諸元	方式	強制熱風循環・換気方式
	温度性能	RT+60℃~+200℃
	内法	W 580 H 800 D 580 mm
	外法	W 1110 H 2100 D 2600 mm ※突起部を含まず
機能	自動扉	上下スライド式自動扉仕様
	冷却機能	ブロフによる強制外気導入方式 (排気孔側面)
	通信機能・搬送機構	上位パソコン通信機能、前後工程との連携機能
	操作パネル	タッチパネルLCD
ユーティリティ	電源、エア	AC200V 3φ 50/60Hz、圧縮空気

### エスペックサーマルテックシステム株式会社

**本社** 住所：埼玉県戸田市美女木東1-2-15  
TEL：048-423-1800 FAX：048-423-1801

**神戸事業所** 住所：兵庫県神戸市中央区港島南町7-2-13  
TEL：078-856-5181 FAX：078-856-5186

製品の改良・改善のため、仕様および外観、その他を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。  
イラストはイメージ図です。詳細・仕様はお問い合わせください。